

JDB920 有机硅导热灌封胶

产品描述

JDB920是一种流动性好，双组分加成型导热有机硅灌封胶，兼具有优异的导热性能和良好的电器绝缘性能，使其非常适应用于电机、功率半导体、晶体闸流管、整流器和变压器等设备或器件的封装。

产品特性

- 低粘度，流动性好；
- 无溶剂，无固化副产物，容易修补；
- 减轻机械、热冲击和震动引起的机械应力和张力；
- 在-50~+200℃间稳定的机械和电气性能；
- 通过了 UL94V0 认证（UL FileNo.E343835），符合 ROHS 要求。

产品用途

用于电机及大功率电子元器件等的散热和封装保护，尤其是对导热性能要求较高的元器件等。

主要性能

项目	典型值		测试标准	
混合前物性 (23±2℃/50±5%RH)				
组分	--	A	B	--
外观	--	白色流体	红色流体	--
粘度 Brookfield DV2T 6#转子, 转速 60r/min	MPa•s	5000±1000	5000±1000	GB/T 2794-2013
比重	g/cm ³	2.6±0.20	2.6±0.20	GB/T 533-2008
混合后物性 (23±2℃/50±5%RH)				
重量比混合	--	A:B=1:1		GB/T 533-2008
外观	--	粉红色流体		---
粘度 Brookfield DV2T 6#转子, 转速 60r/min	MPa•s	5000±1000		GB/T 2794-2013
可操作时间 (25℃)	min	120~150 (可以客户要求制定)		GB/T 7123.1-2015
完全固化时间 (25℃)	h	3~12		GB/T 7123.1-2015
完全固化时间 (80℃)	min	15~30		GB/T 7123.1-2015

固化后性能 (23±2°C/50±5%RH×24hours)			
硬度	ShoreOO	65±10	GB/T 531.1—2008
导热系数	W/m•K	2.0±0.2	ISO22007-2
介电强度	kV/mm	≤15	GB/T 1408.1—2006
体积电阻率	Ω·cm	≥1.0×10 ¹³	GB/T 1410—2006
介电损耗 (60HZ)	--	0.02	GB/T 1409—2006
工作温度	°C	-50~+200	--

使用说明

- 将被施胶物体的表面清理干净，并保持洁净表面干燥。
- 储存中的A, B两个部分在混合前，各自要充分的搅拌均匀。
- 按1: 1质量比混合均匀，倍于胶体体积的容器中，以防脱泡过程中胶体膨胀溢出。
- 混合后可用真空方式去除夹带空气，在28" Hg的真空度下抽气，2分钟可去除气泡，大容积时可延长抽空气时间。

注意事项

- 使用前，请详细查阅MSDS。
- 胶料应密封贮存，混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 本品属非危险品，但避免接触皮肤及眼睛。
- 本产品A组分包含交联剂，B组分包含Pt催化剂。
- 胶液接触一定量的以下化学物质会导致胶不固化：
 - 1、含N、P和S等 的有机化合物。
 - 2、含Sn、Pb、Hg和As 等元素的离子性化合物。
 - 3、含炔烃及多乙烯基的化合物。
- 为了避免上述现象，胶液灌封使用前，应尽量擦干净器件上面残留的松香，尽量使用低铅含量的焊锡。

包装规格

- 40kg/套 (A 组分 20kg/桶+B 组分 20kg/桶)。

储存及运输

- 远离儿童存放，保持 A、B 组分避光和避热，并且密封保存。
- 在 5~30° C 温度之间未开封保存时，产品自生产之日起保质期为 6 个月。
- 本产品为非危险品，按一般化学品贮存、运输。

请仔细阅读

这里包含的所有数据是在嘉多宝实验室测得，仅提供产品选型参考。我们建议在您的实验室或工厂进行足够的测试，以确定该产品是否满足您的所有要求。